

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东会会议，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整前募集资金使用方案

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下募投项目：

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投入额 (万元)
大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目	15,000.00	12,000.00
合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目	35,000.00	20,000.00
补充流动资金（含偿还银行借款）	8,000.00	8,000.00
合计	58,000.00	40,000.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则

不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

二、调整后募集资金使用方案

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下募投项目：

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投入额 (万元)
大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目	15,000.00	12,000.00
合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目	35,000.00	20,000.00
合计	50,000.00	32,000.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

三、履行程序情况的说明

2025年12月23日，公司召开第二届董事会审计委员会会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。会议应出席委员3人，实际出席委员3人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

2025年12月23日，公司召开第二届董事会第十八会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东会审议。

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日